

1310nm SOA半导体光放大芯片COC

见合八方1310nm波长的半导体光放大器（SOA）芯片系列专为低噪声、高灵敏度、低偏振和宽谱SOA模块而设计，符合GR-468-CORE标准。该COC全工艺国产，与国外主流常见产品兼容，并可满足客户快速订制需求，同时交期短、供货快。主要应用于200G/400G PAM4高速业务的通信领域。

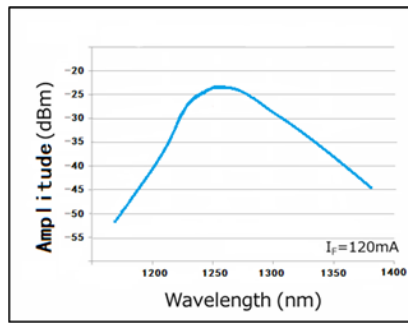
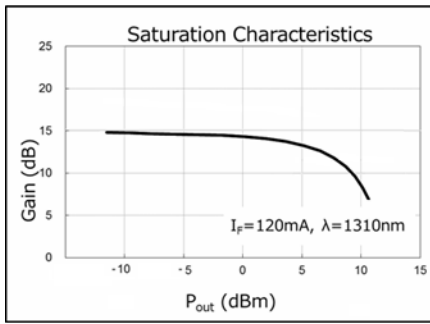
产品特点

- ◆ 芯片 COC 全工艺国产，自主可控
- ◆ 低噪声，高灵敏度
- ◆ 性价比高，交期短，供货快，需求订制，快速迭代

产品应用

- ◆ 用于 200G/400G PAM4 高速业务的光放大
- ◆ GPON 光放大
- ◆ 硅光子集成产品中，用于弥补 1310nm 光信号的传输损耗

典型特性



产品规格（芯片温度@25℃）

参数	符号	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作波长	λ_c	---	1210	1270	1330	nm
谱宽	$\Delta\lambda$	@-3dB	60	---	---	nm
ASE 纹波	Ri	If=120mA	---	0.2	---	dB
工作电流	If	---	---	120	250	mA
正向电压	Vf	---	---	1.3	1.8	V
饱和光功率	Psat	If=120mA	10	---	---	dBm
小信号增益	G	If=120mA Pin=-20dBm	15	18	---	dB
偏振相关增益	PDG	---	---	0.3	1	dB
噪声系数	NF	---	---	7	8	dB
灵敏度@25G		100G ZR4 ROSA 每通道@1.0E-12	---	-24.5	---	dBm
芯片出光角度	---	---	---	30	---	°
光斑尺寸	θ_L/θ_T	---	---	16/30	---	°
热敏电阻阻值	R _{therm}	T=25℃	9.5	10	10.5	KΩ
热敏电阻电流	I _{therm}	---	---	---	5	mA
芯片尺寸(长 x 宽 L x 高)	---	---	900x400x100 (+/-15)			μm
COC 尺寸(长 x 宽 L x 高)	---	---	2.5x0.9x0.45			mm
工作温度	T _c	I=I _{op}	20	---	45	℃

存储温度

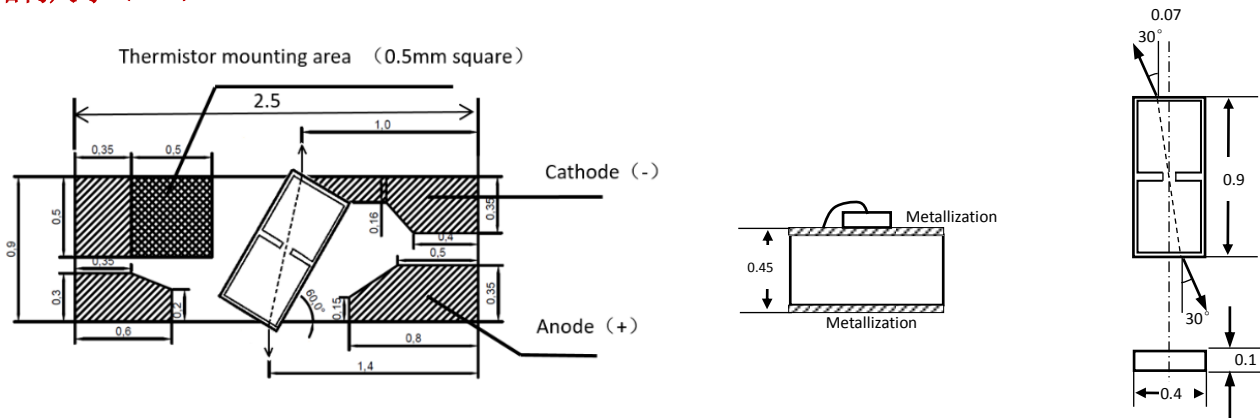
T_{stg}

-40

85

°C

结构尺寸 (mm)



订货信息

订货信息	产品描述	量产阶段
JSA-S3110G18	1310nm-10dBm-18dB- SOA COC	量产